# **Product Specification**

製品規格

108-5956

12MAY2008 Rev.C

# 3 極リーフタイプ Battery コネクタ (3Pos Leaf Type Battery Connector)

### 1. 適用範囲

### 1.1 内容

本規格は 3極リーフタイプ パッテリーコネクタ の製品性能、試験 方法、品質保証の必要条件を規定している。

適用製品名と型番は附表1の通りである。

#### 2. 参考規格類

以下規格類は本規格中で規定する範囲内に於い て、本規格の一部を構成する。万一本規格と製品 図面の間に不一致が生じた時は、製品図面を優先 して適用すること。万一本規格と参考規格類の間 に不一致が生じた時は、本規格を優先して適用す ること。

### 2.1 AMP 規格

109-5000: 試験法の一般条件

B. 501-5561: 認定試験報告書

501-5702: 認定試験報告書

### 2.2 関連規格

Α

### 1 Scope:

### 1.1 Contents

This specification covers the requirements for prod uct performance, test methods and quality assurance provisions of 3Pos. Leaf Battery Conne ctor.

Applicable product description and part numbers are as shown in Appendix 1.

### Applicable Documents:

The following documents form a part of this specification to the extent specified herein. In the event of conflict between the requirements of this specification and the product drawing, the product drawing shall take precedence. In the event of conflict between the requirements of this specification and the referenced documents, this specification shall take precedence.

#### 2.1 AMP Specifications:

Α. 109-5000 Test Specification, General Requirements for Test Methods

B. 501-5561 Qualification Test Report

501-5702 **Qualification Test Report** 

#### 2.2 other Documents

Α

- 3. 一般必要条件
- 3.1 設計と構造

製品は該当製品図面に規定された設計、構造、物理 的寸法をもって製造されていること。

- 3.2 材 料
- a. コンタクト: Cu-Ni-Si

仕上げ: 下地 Ni 1.27 μ m以上 接触部 Au 1 μ m以上 半田付け部 Au 0.05~0.13 μ m

- b. ハウジング: 6 Tナイロン
- c. ソルダーペグ: Brass

仕上げ:下地 Ni 1.27 μ m以上 Sn 1 μ m 以上

3.3 定格

A. 定格電圧 50 VAC RMS

B. 定格電流 2A/1極

C. 使用温度範囲 -55°C~ 85°C

D. 耐久性 6000回 (フル ストローク)

3.4 性能必要条件と試験方法

製品は Fig. 1 に規定された電気的、機械的、及び耐環境的性能必要条件に合致するよう設計されていること。試験は特別に規定されない限り室温下で行われること。

- 3. Requirements:
- 3.1 Design and Construction:

Product shall be of the design, construction and physical dimensions specified on the applicable product drawing.

- 3.2 Materials:
- a. Contact: Cu-Ni-Si

Finish : Ni under plating 1.27  $\mu$  min over contact area Au 1  $\mu$  m min soldering area Au 0.05~0.13  $\mu$  m

- b. Housing: 6T Nylon
- c. Solder PEG: Brass

Finish : Ni under plating 1.27  $\mu$  min over Sn 1  $\mu$  m min

- 3.3 Ratings:
  - A. Voltage Rating: 50 VAC RMS
  - B. Current Rating: 2A/contact
- C. Temperature Rating: 55 °C to 85 °C
- D. Durability: 6000cycles (Full stroke)
- 3.4 Performance Requirements and Test Descriptions :

The product shall be designed to meet the electrical, mechanical and environmental performance requirements specified in Fig. 1. All tests shall be performed in the room temperature, unless otherwise specified.

Rev. C 2 of 8



# 3.5 性能必要条件と試験方法の要約

3.5 Test Requirements and Procedures Summary

		試 験 方 法				
Test Items	Requirements	Procedures				
製品の確認	製品図面の必要条件に合致していること。					
		10倍拡大鏡を使用				
Examination of Product	Meets requirements of product	Visual inspection				
	drawing.	No physical damage				
		Magnification 10X				
14.51.14.11	1					
		ハウジングに組み込まれ嵌合したコンタ				
, ,	試験後:25 mΩ 以下 	クトを開路電圧 20 mV 以下、閉路電流				
3.6.1 参照		10mA 以下の条件で測定する。3.6.1参照 				
Contact Resistance (Low	Initial: 15 m Ω Max.	Subject mated contacts assembled in				
Level)	Final: 25 m Ω Max.	housing to 20 mV Max open circuit at				
See para. 3.6.1		10mA. See also para. 3.6.1				
   絶縁抵抗	100 ΜΩ 以上	100 V DC 印加。				
		コネクタ嵌合なし				
		隣接コンタクト間で測定。				
		IEC 60512-2 test 3a に準拠				
Insulation Resistance	100 MΩ Min.	Impressed voltage 100 V DC.				
		unmated connectors.				
		In acc. with IEC 60512-2 test 3a				
耐電圧	沿面放電、フラッシュオーバー	500VAC 1 分間印加				
	等がないこと。	コネクタ嵌合なし				
		IEC 60512-2 test 4aに準拠				
Voltage proof	No creeping discharge no	500VAC for 1 minute.				
	flashover shall occur.	unmated connectors.				
		In acc. with IEC 60512-2 test 4a				
温度上昇	定格電流を通電して、温度上昇 は30℃ 以下	通電による温度上昇を測定すること。				
Temperature Rising	30°C Max. under loaded rating	Measure temperature rising by energized				
	current.	current.				
	Examination of Product  接触抵抗 (ローレベル) 3.6.1 参照  Contact Resistance (Low Level) See para. 3.6.1  絶縁抵抗  Insulation Resistance  耐電圧  Voltage proof  温度上昇	にること。  Examination of Product Meets requirements of product drawing.  電気的性能 Electrical Requirements 接触抵抗 (ローレベル) 3.6.1 参照  Contact Resistance (Low Level) See para. 3.6.1  絶縁抵抗 100 MΩ 以上  Insulation Resistance 100 MΩ Min.  耐電圧 沿面放電、フラッシュオーバー等がないこと。  Voltage proof No creeping discharge no flashover shall occur.  温度上昇 定格電流を通電して、温度上昇は30°C 以下  Temperature Rising 30°C Max. under loaded rating				

Fig. 1 (続く) Fig.1 (CONT.)

Rev. C 3 of 8

項目	試験項目	規規	各 値	試 験 方 法					
Para.	Test Items	Require	ements	Procedures					
		機 械	的性能						
		Mechanic	al Requirements						
3.5.6	コンタクト接圧	変位量 (mm)	荷重 (N)	接圧、変位カーブ					
		0.0	0.3ref						
		0.7	1.0+0.25/-0.15						
3.5.6	Contact normal force	Deflection	Normal Force	Normal force test equipment					
		(mm)	(N)	(Force/ Deflection curve)					
		0.0	0.3ref						
		0.7	1.0+0.25/-0.15						
3.5.7	振動	振動中 1 μ sec	. をこえる不連	振動周波数: 10-55-10Hz / 振幅:1.5mm					
	(定周波)	続導通を生じな	いこと。	振動方向:3方向					
		物理的損傷のな	いこと。	振動時間:各2時間					
		接触抵抗 3.5.2	を満足する事						
3.5.7	Vibration	No electrical discontinuity		Vibration Frequency: 10-55-10Hz /1.5mm					
	(Sinusoidal)	greater than 1 $\mu$	sec. shall	Vibration Direction: 3directions.					
		occur.		Duration: 2 hours each					
		No physical dan	•						
		To meet the spe							
3.5.8	<b>  衝撃</b>		た。をこえる不連	加速度: 490 m/s <sup>2</sup>					
		続導通を生じな		衝撃回数:X,Y,Z 軸方向に各3 回迄、					
		物理的損傷のな		合計 18 回					
0.5.0	DI : 101 1	接触抵抗 3.5.2		A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
3.5.8	Physical Shock	No electrical dis	•	Accelerated Velocity: 490 m/s <sup>2</sup>					
	greater than 1 $\mu$ sec. shall		sec. snall	Number of Drops: 3 drops each directions					
		No physical damage.		of X, Y and Z axes, totally 18 drops.					
3.5.9	<b>数据的报</b>	To meet the spec 3.5.2		6 000回接触 フリストローク(1 2mm亦位)					
3.5.9	機械的操作 	接触抵抗 3.5.2 を満足する事		6,000回接触、フルストローク(1.3mm変位)					
3.5.9	.5.9 Mechanical Operation To meet the spec 3.5.2		10サイクル/1分 Speed; 10~20mm/min 6,000 mating cycles						
5.5.5   Meditanical Operation   10 meet the spec 5.5.2		50 J.J.∠	Full stroke: 1.3mm displacement.						
				10-cycle/1 minute. Speed; 10~20mm/min					
3.5.10	はんだ付け性	95% 以上ぬれ	ていること	to-cycle/1 minute. Speed, 10~20mm/min   はんだ温度:235 ± 5°C					
5.5.10	10/0/~ 1317 II	90 /0 XI 04/L	C 0 .	はんだ温度 . 235 ± 5 C					
3.5.10	Solder ability	Wet Solder Cov	erade.	Solder Temperature: 235 ± 5°C					
5.5.10	Joiner ability	95 % Min.	craye.	Immersion Duration : 5 ± 0.5 seconds					
		JJ 70 IVIIII.		minoration Duration . 3 ± 0.0 36001103					

Fig. 1 (続く) Fig.1 (CONT.)

Rev. C 4 of 8

項目	試験項目	規 格 値	試 験 方 法					
Para.	Test Items	Requirements	Procedures					
	環境的性能							
	Environmental Requirements							
3.5.11	耐湿 (定常)	接触抵抗 3.5.2,絶縁抵抗 3.5.3	温度 60℃ 湿度 95 %R. H.					
		耐電圧 3.5.4を満足する事	96時間					
3.5.11	Damp/heat steady state	To meet the spec 3.5.2, 3.5.3 60°C, 95 % R. H. 96 hrs.						
		And 3.5.4						
3.5.12	温度寿命 (耐熱)	接触抵抗 3.5.2 を満足する事	85°C、96時間					
3.5.12	Heat Age test	To meet the spec 3.5.2	85°C, Duration: 96 hrs.					
3.5.13	はんだ耐熱性	試験後物理的損傷を生じない	図3に示すプロファイルにてIRリフロー槽					
	3.6.2 参照	こと。	で2回					
		(クラック、かけ、溶け)						
3.5.13	Resistance to Soldering	No physical damage shall	2cycles of heat curve covering IR					
	Heat	occur.	soldering curve specified figure 3.					
	See para. 3.6.2	(Cracks, chips or melting)						
3.5.14	熱衝撃	接触抵抗 3.5.2,絶縁抵抗 3.5.3	-55°C/30 分、85°C/30 分					
		耐電圧 3.5.4を満足する事	これを 1サイクルとし 5サイクル行う。					
3.5.14	Rapid change of	To meet the spec 3.5.2, 3.5.3	−55°C / 30 min. ,					
	temperature	And 3.5.4	85°C /30 min.					
			Making this a cycle, repeat 5 cycles.					
3.5.15	塩水噴霧	接触抵抗 3.5.2 を満足する事	5% の塩水噴霧に48時間さらす。					
		外観等 甚だしい腐食なきこと。						
3.5.15	Salt Spray	To meet the spec 3.5.2	5 % salt concentration for 48 hours:					
		No corrosion shall occur.						
3.5.16	亜硫酸ガス	接触抵抗 3.5.2 を満足する事	ガス濃度 10±3cm³/m³ 温度40±2°C					
		外観等 甚だしい腐食なきこと。	湿度 75%RH					
			48時間					
3.5.16	SO <sub>2</sub> Gas	To meet the spec 3.5.2	10±3cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> 40±2°C					
		No corrosion shall occur.	75%RH					
			48hours					

Fig. 1 (終り)

Fig. 1 (End)

Rev. C 5 of 8

- 3.6 試験法の詳細(追記)
- 3.6 Additional Testing Details
  - 3.6.1 総合抵抗 (ローレベル) 測定方法
  - 3.6.1 Terminal Resistance

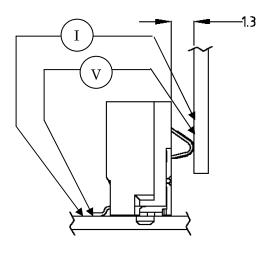


図 2

Figure 2.

Rev. C 6 of 8

### 3.6.2 IR リフロー プロファイル

はんだ耐熱性試験サンプルは、プリント基板面上に置く。赤外線/熱風リフロー槽のプロファイルは、図4に示すように調整する。図4の全ての温度は、プリント基板表面上の部品上面を測定する。試験後サンプルは、室温で5分間以上、冷却すること。

### 3.6.2 IR Reflow Profile

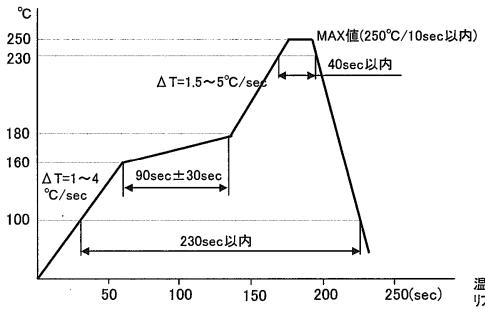
Resistance to soldering heat test samples shall be placed on a bare surface of a Printed Circuit Board.

Test heat-curve shall cover the IR/Convection solder reflow conditions as Indicated In figure 4.

All temperatures refer to the topside of the package as measured on the PC-board surface.

Between exposures, parts shall be allowed to cool down to room temperature, for 5 minutes minimum.

# Temperature profile of Infrared Reflow



温度設定:(半田接合部)

リフロー回数:2回

図 3

Figure 3.

Rev. C 7 of 8

# 4. 製品認定試験の試験順序

# 4. Product Qualification Test Sequence

		試験グループ/Test Group							
試験項目	Test Items	1	2	3	4	5	6	7	8
				試験順	序/Test	Seque	nce (a)		
製品の確認検査	Examination of Product	1,7	1,9	1,10	1,10	1,3	1,6	1,6	1,4
接触抵抗 (ローレベル)	Contact Resistance (Low Level)	3,6	4,8	3,7	3,7		3,5	3,5	
絶縁抵抗	Insulation Resistance			4,8	4,8				
耐電圧	Dielectric withstanding Voltage			5,9	5,9				
温度上昇	Temperature Rising								3
コンタクト接圧	Contact normal force		3,7						
振動(定周波)	Vibration (Sinusoidal)	4							
衝撃	Physical Shock	5							
機械的操作	Mechanical Operation		5						
はんだ付け性	Solder ability					2			
耐湿	Damp/heat Steady state			6					
温度寿命 (耐熱)	Heat Age test		6						
はんだ耐熱性	Resistance to Soldering Heat	2	2	2	2		2	2	2
熱衝撃	Rapid change of temperature				6				
塩水噴霧	Salt Spray						4		
SO₂ガス	SO <sub>2</sub> GAS							4	

<sup>(</sup>a) 欄内の数字は試験の順序を示す。/Numbers indicate sequence in which the tests are performed.

# 適用製品名と型番は附表 1 の通りである。

The applicable product descriptions and part numbers are as shown in Appendix. 1.

型番	品名	Description				
Product Part No.		Beschption				
1746142-1	3極 リーフタイプBatteryコネクタ	3Pos. Leaf Type Battery Connector				
1827928-1	3極 リーフタイプBatteryコネクタ	3Pos. Leaf Type Battery Connector				
1981061-1	3極 リーフタイプBatteryコネクタ Without BOSS	3Pos. Leaf Type Battery Connector Without BOS				
2040598-1	3極 リーフタイプBatteryコネクタ	3Pos. Leaf Type Battery Connector				

附表 1 Appendix 1

Rev. C 8 of 8